

2018-2024年中国LED封装行业市场发展模式调研 及投资趋势分析研究报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2018-2024年中国LED封装行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201806/653917.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

2017年中国LED行业总体规模6538亿元，同比增长25%，上游芯片高速增长，中游封装平稳发展，下游应用维持快速增长态势。预计2018-2020年中国LED产业产值规模复合增长率将达18%左右，LED行业的整体增长趋势比过去两三年要快，下游需求的强劲将带动整个行业持续成长。此外，半导体照明十三五规划指出，到2020年中国LED整体产值将达一万亿，接近现有产值的两倍。

就封装市场来看，2017年国内市场规模达963亿，同比增长29%。预计2018-2020中国LED封装行业将维持13%-15%的增速，2020年产值规模将达1288亿元。

中国LED各板块市场规模及整体市场规模增速

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2018-2024年中国LED封装行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》共十二章。首先介绍了LED封装产业相关概念及发展环境，接着分析了中国LED封装行业规模及消费需求，然后对中国LED封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国LED封装行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国LED封装行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 发展现状与前景分析

第一章 LED封装相关概述

第一节 LED概念及应用领域

一、LED的概念及其发光原理

二、LED与传统灯的运行对比

三、LED灯的分类

四、LED的产业链

第二节 LED封装概念

第三节 LED封装结构分类

第四节 LED的技术水平和技术特点

一、LED封装技术水平

二、LED封装的技术特点

第五节 LED封装发展趋势

第六节 LED封装行业管理

一、行业管理部门

二、行业协会

三、行业主要政策

四、行业主要法律法规

第二章 中国LED封装产业整体运营态势分析

第一节 封装行业的市场格局

一、全球封装产业市场格局

借助于国内劳动力的成本优势和政府的产业优惠政策，全球LED封装产业加快向大陆转移。国首尔半导体、三星、CREE、Lumileds等国外品牌大厂将代工订单逐渐往中国集中，中国成为LED全球产能中心。

全球封装产值占比

数据来源：公开资料整理

二、中国封装行业市场规模及增长情况

三、中国大陆LED封装行业竞争格局

第二节 LED封装行业市场需求状况

一、LED行业发展前景与市场容量

二、价格走势影响因素

第三节 行业需求特征

一、需求周期性

二、需求区域性

三、需求季节性

第四节 国内重要LED封装项目的建设

一、韩企投资扬州兴建LED封装基地

二、西安经开区LED封装线项目投产

三、长治高科LED封装项目竣工投产

第五节 影响行业发展的有利和不利因素及进入行业的主要障碍

一、影响行业发展的有利因素

二、影响行业发展的不利因素

第六节 进入LED行业的主要障碍

一、产品生产技术

二、工艺流程的管理和控制能力

三、企业规模

四、客户资源

五、产品质量和品牌效应

第七节 预投资项目评估

一、主要设备预估清单

二、人员定编及配置

三、投资估算

四、安全生产及环境要求

第二部分 市场竞争格局与形势

第三章 2014-2018年中国LED封装市场新格局透析

第一节 2014-2018年中国LED封装市场发展态势

一、中国成中低端LED封装重要基地

二、国内LED封装企业发展不平衡

三、中国LED封装市场缺乏大型企业

四、LED产业上游厂商涉足封装市场

五、台湾LED封装产能向大陆转移

第二节 中国LED封装企业分布状况

第三节 广东省LED封装业

一、主要特点

二、重点市场

三、发展趋势

第四章 2014-2018年中国LED封装行业技术研发进展状况

第一节 中外LED封装技术的差异

一、封装生产及测试设备差异

二、LED芯片差异

三、封装辅助材料差异

四、封装设计差异

五、封装工艺差异

六、LED器件性能差异

第二节 中国LED封装技术发展概况

一、封装技术影响LED产品可靠性

二、中国LED业专利集中在封装领域

三、中国LED封装业的技术特点

四、LED封装技术水平不断提升

五、LED封装业技术研发仍需加强

第三节 LED封装关键技术介绍

一、大功率LED封装的关键技术

二、显示屏用LED封装的技术要求

三、固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2014-2018年中国LED封装设备及封装材料的发展

第一节 LED封装设备市场分析

一、我国LED封装设备市场概况

二、LED封装设备国产化亟需加速

三、发展我国LED封装设备业的思路

第二节 LED封装材料市场分析

从上游采购的角度来看，生产规模的扩大，有利于对原材料成本的控制。封装厂商的主要成本来自原材料芯片的采购，占总成本的45.6%。

中国LED封装企业成本拆分

数据来源：公开资料整理

2017年中国主要LED封装企业管理费用占比

数据来源：公开资料整理

一、LED封装主要原材介绍

二、我国LED封装材料市场简析

三、部分关键封装原材料仍依赖进口

四、LED封装用基板材料市场走向分析

第三节 LED封装支架市场

一、国内LED封装支架市场格局分析

二、LED封装支架技术未来发展趋势

三、我国LED封装支架市场前景广阔

第三部分 赢利水平与企业分析

第六章 2014-2018年中国LED封装产业竞争新形态分析

第一节 2014-2018年中国LED封装市场竞争格局

一、中国采购影响世界封装市场格局

二、我国LED封装市场各方力量简述

三、国内LED封装市场竞争加剧

四、本土LED封装企业整合步伐加速

第二节 2014-2018年中国LED封装企业竞争力简析

一、2014-2018年本土封装企业竞争力排名

二、2014-2018年本土LED封装企业竞争力排名

第三节 2014-2018年中国LED封装竞争趋势预测分析

第七章 2014-2018年全球LED封装顶尖企业分析

第一节 科锐 (CREE)

- 一、企业概况
- 二、企业LED封装运营态势
- 三、企业发展战略分析

第二节 日亚化学 (NICHIA)

- 一、企业概况
- 二、企业LED封装运营态势
- 三、企业发展战略分析

第三节 飞利浦 (Philips)

- 一、企业概况
- 二、企业LED封装运营态势
- 三、企业发展战略分析

第四节 三星LED (SamsungLED)

- 一、企业概况
- 二、企业LED封装运营态势
- 三、企业发展战略分析

第五节 首尔半导体 (SSC)

- 一、企业概况
- 二、企业LED封装运营态势
- 三、企业发展战略分析

第四部分 投资策略与风险预警

第八章 2014-2018年中国内地主要LED封装重点企业

第一节 佛山市国星光电股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、组织结构
- 三、产品结构
- 四、生产工艺

第二节 深圳市瑞丰光电子股份有限公司

- 一、公司概况
- 二、公司组织结构图
- 三、产品结构和主要客户
- 四、工艺流程

第三节 广州市鸿利光电股份有限公司

- 一、公司简介

二、公司组织结构

三、产品结构

四、工艺流程

第四节 深圳万润科技股份有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、产品工艺流程图

第五节 深圳雷曼光电科技股份有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、工艺流程图

第六节 江西联创光电科技股份有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、工艺流程图

第七节 广东佛山国星光电有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、工艺流程图

第八节 品能光电技术（上海）有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、工艺流程图

第九节 厦门三安电子股份有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、工艺流程图

第十节 杭州士兰微电子股份有限公司

一、企业简介

二、公司组织结构图

三、产品结构

四、工艺流程图

第九章 2018-2024年中国LED封装产业发展趋势及前景

第一节 2018-2024年LED封装产业未来发展趋势

一、功率型白光LED封装技术发展趋势

二、LED封装技术将向模块化方向发展

三、LED封装产业未来发展走向分析

第二节 2018-2024年中国LED封装市场前景展望

一、我国LED封装市场发展前景乐观

二、LED封装产品应用市场将持续扩张

三、中国LED通用照明封装市场规模预测

第十章 2018-2024年中国LED封装产业投资前景预测

第一节 2018-2024年中国LED封装行业投资概况

一、LED封装行业投资特性

二、LED封装具有良好的投资价值

三、LED封装投资环境利好

第二节 2018-2024年中国LED封装投资机会分析

一、LED封装投资热点（LED照明、LED照明电视）

二、国家节能减排衍生LED封装投资机会

第三节 2018-2024年中国LED封装投资风险及防范

一、技术风险分析

二、金融风险分析

三、政策风险分析

四、竞争风险

第四节 专家建议

一、战略建议

二、财务建议

第十一章 中国LED封装产业发展策略分析(ZYZF)

第一节 市场策略分析

一、价格策略分析

二、渠道策略分析

第二节 销售策略分析

一、媒介选择策略分析

二、产品定位策略分析

三、企业宣传策略分析

第三节 提高企业竞争力的策略

一、影响企业核心竞争力的因素及提升途径

二、提高企业核心竞争力的策略

第四节 对我国品牌的战略思考

一、实施品牌战略的意义

二、企业品牌现状分析

三、品牌战略管理策略(ZYZF)

图表目录：

图表：LED构造和发光原理

图表：传统灯与LED等运行数据对比

图表：LED分类及用途

图表：LED产业链分析

图表：按封装形式与特征划分的LED器件分类

图表：2018年全球LED封装市场份额

图表：中国LED市场规模及增长情况

图表：中国LED封装厂商分布区域及特点

图表：2018-2024年全球LED按应用领域需求量预测

图表：2008 -2018年中国LED封装产值规模

图表：国内LED封装设备需求及预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201806/653917.html>